

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2026-038

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，提升核心竞争力，充分保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，公司结合自身发展战略及经营情况，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将 2026 年“提质增效重回报”的行动方案主要措施公布如下：

一、聚焦主业经营，夯实高质量发展根基

（一）深耕主营业务，提升经营质效

公司是一家主要从事芯片设计业务的 Fabless 芯片设计公司，根据咨询机构 TrendForce 数据，公司是全球前十大无晶圆厂半导体公司之一，半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案三大核心板块。作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，公司图像传感器解决方案市场份额位列全球第三，公司产品已广泛覆盖汽车、智能手机、家居安防、医疗、工业/机器视觉、新兴市场等领域。依靠公司在高端图像传感器产品的持续研发投入及高效的成果转化，公司聚焦主营业务，在诸多领域夯实市场领先地位，巩固并提升了公司的核心竞争力。

公司持续深化技术改革与先进技术成果转化，持续丰富公司在高端应用场景的产品序列，伴随在汽车智能驾驶领域渗透加速，以及在全景、运动相机等智能终端影像应用市场的显著扩张，相关领域的市场份额持续提升。2025 年度，公司

营业收入实现稳步增长,在营收规模持续扩张的同时,依托管理效能的持续优化,公司净利润与整体盈利能力同步得到有效释放与稳步提升,公司实现营业收入288.55亿元,较2024年增加12.14%。其中半导体设计业务产品销售收入实现238.00亿元,占主营业务收入的比例为82.60%,较上年增加9.98%;公司半导体代理销售业务实现收入49.05亿元,占公司主营业务收入的17.02%,较上年增加24.52%;公司归属于母公司股东的净利润为40.45亿元,较2024年增长21.73%。2025年公司半导体设计业务中,图像传感器解决方案业务实现营业收入212.46亿元,占主营业务收入的比例为73.73%,较上年增加10.71%,主要得益于公司面向汽车智能驾驶及新兴应用市场的图像传感器产品销售收入实现大幅增长。

公司所处的半导体行业是国家高新技术产业发展的关键环节,当前国内半导体企业正面临前所未有的机遇与挑战。为积极应对行业变化,公司持续强化在汽车电子及新兴市场 CIS 领域的竞争优势。在汽车图像传感器方面,公司推出了新一代采用 TheiaCel®技术的 800 万像素 CMOS 图像传感器 OX08D20。该产品是热门传感器 OX08D10 的升级版本,专为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)中的汽车外部摄像头设计。除延续行业领先的暗态性能外,OX08D20 还具备低功耗优势,并采用 a-CSP™封装,其尺寸比同类外部传感器缩小 50%。与此同时,公司的 LCOS 产品凭借特有的一体化驱动设计,实现了体积小、像素密度大、像素间距窄、功耗低以及显示效果优异等特点,已在智能眼镜(包括 AR/XR/MR 眼镜)、微型投影、汽车增强现实抬头显示(AR-HUD)以及全光通信传输网的波长选择开关(WSS)中实现量产供应。2025年,公司发布了业界首款面向新一代智能眼镜的超低功耗单芯片硅基液晶(LCOS)小面板——OP03021 LCOS 面板。该产品采用 0.26 英寸光学尺寸,在 90Hz 场序输入下实现 1632×1536 的分辨率,能够助力新一代智能眼镜获得更高分辨率与更宽视场角(FoV)。这些特性正是消费者迫切需要的,可在智能眼镜日益普及的趋势下,带来更沉浸、更逼真、更舒适的增强现实(AR)体验。值得一提的是,OP03021 全彩场序 LCOS 面板是目前市场上唯一一款将阵列、驱动器和存储器集成到超低功耗单芯片架构中的智能眼镜解决方案。

2026年,全球半导体产业受 AI 基础设施建设影响,细分领域供需关系出现扰动,消费终端市场承压明显。面对这一形势,公司将把握人工智能与实体经济

深度融合的时代机遇，深化全球市场布局，强化“A+H”资本平台协同，积极开拓新兴下游应用场景，稳健开拓产品版图。同时，公司将持续深耕核心技术，加大新产品开发，进一步丰富产品矩阵，扩大半导体设计业务的产品类型与应用范围。此外，公司将结合行业特点与发展阶段，提前布局前沿技术，优化创新要素配置，提升研发与生产效率，并通过清晰的产品和市场定位构建稳定、高效的营销模式，形成差异化竞争优势。

（二）深化供应链整合，提升资产运营效率

公司与已有的晶圆厂、封装厂持续开展深度合作，同时在充分保障产品质量的前提下，持续优化公司的供应链布局，既有效保障了日益增长的产能需求，又进一步缩短了供应链响应周期、降低了综合制造成本。公司统筹各业务板块发展战略，充分发挥图像传感器、显示、模拟解决方案等业务体系在客户资源与供应链环节的协同效应，为客户提供整体的解决方案，持续提升整体生产效能与运营效率。

受益于上述供应链优化举措及产品结构升级的共同驱动，2025 年度公司主营业务毛利率达 30.59%，较上年同期提升 1.23 个百分点。营业成本增幅低于营业收入增幅，主要得益于产品结构优化以及成本控制等因素，有效压降了单位产品制造成本。

2026 年，公司将继续强化供应链管理体系建设，进一步优化存货结构，加快存货周转效率，降低资金占用水平。公司将通过精细化管理和技术升级，持续推进各环节的成本优化，不断提升资产运营效率和盈利质量。

（三）深化并购整合，提升规模效益

自上市以来，公司借助资本市场丰富的融资工具，通过并购重组实现了业务规模的重大突破，从原有的模拟业务扩充到了图像传感器及显示芯片业务，产品矩阵不断丰富，实现了各业务板块的高质量协同发展。

2026 年，公司将持续关注市场潜在上下游并购机会，通过并购和投资进一步扩大公司的可触达市场，重点关注有益于公司产品组合的多样化及有益于扩大公司对邻近市场的覆盖的投资并购标的。凭借公司在通过收购扩大解决方案和业

务规模方面的成功经验，公司将继续寻求和评估潜在的目标或战略合作，以便在技术、知识产权、产品和解决方案、供应链、客户群和长期增长机会方面创造强大的协同效应。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

作为采用 Fabless 业务模式的半导体设计销售业务公司，公司的持续研发能力是公司的核心竞争力。公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发，以客户需求为导向不断创新研发机制，并持续稳定的加大在各产品领域的研发投入，加速研发成果转化，为产品升级及新产品的研发提供了充分的保障，使得公司产品竞争力稳步提升，研发投入的产出效益持续提高。

2025 年，公司半导体设计销售业务研发投入金额约为 36.80 亿元，占公司半导体设计销售业务收入的 15.46%，较上年增长 13.38%；截至 2025 年末，公司共有研发人员人数为 2,681 名，其中硕士以上学历占比为 61.06%；并拥有授权专利 4,993 项，其中发明专利 4,787 项，实用新型专利 206 项。另外，公司拥有布图设计 136 项，软件著作权 86 项。

公司持续突破关键技术瓶颈，不断提升高端图像传感器产品的成像性能与集成度，为多领域应用筑牢技术根基。紧抓汽车智能化发展机遇，公司以全球领先的市场份额优势，为高阶自动驾驶系统提供高安全性、高可靠性的视觉感知支撑；随着车联网、智能汽车、自动驾驶的普及，车载摄像头数量快速攀升，应用场景从传统倒车影像、行车记录仪向电子后视镜、360 度全景成像、自动驾驶及驾驶员监控持续延伸，公司汽车市场相关收入保持快速增长，充分验证了公司在高端车载图像传感器领域的深厚技术积累与强劲竞争力。面向全球医疗健康需求升级，公司微型镜头模组解决方案凭借小型化、高精度的特点，可满足微创手术、手术机器人等场景的极致应用要求。同时，公司积极拥抱人工智能技术变革，加速推动端侧 AI、机器视觉等新兴场景落地，持续为终端产品赋予智能化体验与核心竞争力。在智能手机领域，公司高端图像传感器产品凭借优异的性能表现，已广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄方案，市场份额稳步扩大，实现了高端智能手机领域的持续突破。

2026年，公司将充分利用在产品研发上的深厚经验及知识产权积累，持续加大在高端图像传感器、汽车电子、新兴市场等前沿领域的研发投入，进一步扩大竞争优势。公司将通过高效的技术开发、产品技术创新，不断丰富产品矩阵，持续为客户创造价值，构建产品研发的技术护城河，优化公司竞争格局，推进公司稳步高速持续增长。

三、健全治理体系，提升规范运作水平

（一）完善规章制度，提高治理水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，结合公司当年发展情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运营运作。

2025年度，公司依据《上市公司章程指引》及实际情况，不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会全面承接，并已完成《公司章程》及相关制度的配套修订。同时，公司持续深入落实独立董事制度履职保障机制，严格遵循《独立董事工作细则》，推动独立董事与公司管理层及外聘中介机构的定期沟通，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

为贯彻落实国务院国资委及中国证监会关于上市公司市值管理工作的相关要求，公司已制定《市值管理制度》，明确市值管理目标、职责分工与资本运作路径，综合运用股份回购、现金分红、并购重组、股权激励等手段，持续提升公司投资价值与股东回报水平。公司高度重视舆情管理工作，已制定《舆情管理制度》，建立舆情监测、研判、应对及报告的全流程管理机制，有效防范和化解舆情风险，切实维护资本市场良好形象。

2026年，公司将持续优化治理架构与制度体系，根据《公司法》及监管政策最新要求，持续修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度，优化董事会各专门委员会运作机制，充分发挥审计委员会、战略

与 ESG 委员会等的专业作用，提升公司决策的科学性与效率。

（二）深化 ESG 体系建设，推进可持续发展

公司秉持“赋能科技，感知无限”的使命宣言，“强协同为用户创新更大价值”的服务理念，在“持续技术创新多元杰出的人才高度协同的供应链与客户群”核心竞争力的依托下搭建公司可持续发展策略，并建立了由董事会、战略与 ESG 委员会及战略与 ESG 工作小组构成的三级 ESG 管治架构，明确其对应的 ESG 管治职能，实现自上而下的 ESG 事宜监管，保障公司 ESG 工作的顺利开展，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

公司在 ESG 领域持续深耕，已根据相关要求连续 6 年编制《环境、社会及管治报告》，以透明和负责任的态度向公众展示公司在 ESG 领域的理念、战略、行动及成果。公司积极响应全球气候变化挑战，下属美国豪威已提交科学碳目标倡议（SBTi）承诺书，承诺短期、长期及净零温室气体减排目标，且该目标已于 2025 年 1 月通过了 SBTi 审验。同时，美国豪威已完成 OV10652 的产品碳足迹核算，通过精准识别产品生产全链路排放源，为产品端精细化减排管理奠定良好基础。此外，美国豪威亦积极响应 CDP 气候变化问卷，并取得 B-评级，充分体现其在气候治理、碳排放管理等方面的美好成效。

公司在国际权威评级机构 MSCI 的 ESG 评级中获评 BBB 级，并在 Wind ESG 评级连续三年保持稳定在 A 级水平。

2026 年，以 H 股上市为契机，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作满足 A+H 两地监管合规要求，深化绿色运营举措，加大在节能减排、资源循环利用、绿色产品研发等领域的投入力度，积极应对气候变化挑战，严格落实环境合规管理要求，努力实现绿色运营与企业价值的协同增长，提升公司的长期可持续发展能力。

四、强化“关键少数”责任，筑牢规范运营防线

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司已制定《高级管理人员薪酬绩效管理办法》《高级管理人员薪酬追回制度》，并于 2026 年 3 月 6 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，旨在进一步规范公司治理，引导董事及高级管理人员

在履职过程中兼顾个人价值实现与企业社会责任，切实保障公司可持续发展。

2026年，公司将持续完善董高薪酬相关制度和方案，科学设定股权激励计划的业绩考核指标。加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，推动管理层与股东利益深度绑定，切实推动公司高质量发展。公司将组织相关人员积极参加证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的培训，持续学习最新法律法规，掌握证券市场相关规则，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

五、强化股东回报举措，现金分红与回购并举

（一）持续推进一年多次现金分红，构建稳定回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《豪威集成电路（集团）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

2025年度，公司分别实施了2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配方案，共计派发现金红利746,652,847.24元。2025年4月16日，公司发布了2024年度利润分配的方案，并于2025年8月1日完成了此次利润分配，共计派发现金红利264,459,672.84元。2025年10月29日，公司发布了2025年度中期利润分配的方案，并于2025年11月24日完成了此次利润分配，共计派发现金红利482,193,174.40元。

2026年，公司将在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况，继续推行一年多次现金分红的股东回报

模式。公司将严格执行《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，在保证主营业务发展合理需求的同时，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

（二）持续落实回购方案，推进回购股份注销

自公司上市以来，公司持续以自有资金通过集中竞价交易方式开展股份回购，积极提振市场信心，共推出5次股份回购方案，已实施完成的方案累计回购金额约为19.35亿元。

2025年4月15日，公司召开第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》，将2024年度回购的11,213,200股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。公司本次注销的回购股份对应回购金额约10亿元，并已于2025年8月完成注销手续，公司总股本相应减少11,213,200股，有利于增厚每股收益，切实提高股东投资回报，增强投资者对公司的投资信心。

2026年，公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购金额不低于8亿元、不高于10亿元，回购价格不高于100元/股，回购股份拟全部用于后续实施员工持股计划或股权激励，以进一步完善长效激励机制，充分调动核心人员积极性。同时，公司计划将2023年回购股份方案中已回购但尚未使用的3,921,163股库存股用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并相应办理注销手续。此外，公司将根据市场情况和经营发展需要，适时评估并推进股份回购计划的实施，在符合条件的情况下研究推进回购股份注销，持续提振市场信心，增厚股东权益。

六、加强投资者沟通，传递公司长期价值

（一）提高信息披露水平，增强信息可读性

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和

透明度，并常态化通过长图文、视频、公司官方公众号等形式对公司业务及定期报告进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、全方位地呈现在投资者面前。公司同时持续编制和披露 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

（二）拓宽投资者沟通渠道，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。同时，公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，并已设立专职人员负责投资者关系，积极通过常态化召开业绩说明会（每年召开不少于 3 次）、上证 e 互动、股东会、投资者交流会、调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

2026 年，公司将继续遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。公司将安排专人及时接听投资者热线、回复投资者邮箱及“上证 e 互动”平台咨询，确保投资者日常关切得到及时回应。公司将常态化召开业绩说明会，每年不少于 3 次，并邀请高管团队共同参与。在年度报告及半年度报告发布后，公司将分别推出 1 期长图文解读材料，以直观、生动的方式阐释业绩亮点与发展趋势，提升信息披露的可读性与透明度。公司将在合规前提下丰富沟通方式，邀请董事、管理层及业务负责人参与投资者关系活动，积极传递公司长期投资价值，增强市场对公司的认可度与信任度。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承

诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日